

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于签署兴办软硬结合板生产项目之补充协议二的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 26 日、2020 年 9 月 7 日与鹰潭高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“鹰潭高新区管委会”）分别签署了《关于兴办软硬结合板生产项目合同书》及《补充协议》，公司拟在鹰潭高新区白露科技园内设立项目公司，兴办软硬结合板生产项目，具体详见公司在巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的有关公告。

公司于 2023 年 12 月 1 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于“兴办软硬结合板生产项目”之补充协议二的议案》，现将有关情况公告如下：

一、补充协议二概述

为支持公司控股子公司江西弘信柔性电子科技有限公司（以下简称“江西弘信”）扩产项目建设，鹰潭高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“鹰潭高新区管委会”）、江西弘信双方经友好协商，现在原合同书和原补充协议的基础上进行补充。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本议案属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次补充协议二不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作对方基本情况

- 1、单位名称：鹰潭高新技术产业开发区管理委员会
- 2、统一社会信用代码：123606005711988077

3、举办单位：鹰潭市人民政府

4、注册地址：鹰潭市工业园区和谐路 12 号

5、法定代表人：肖霖

6、开办资金：249 万元人民币

7、宗旨和业务范围：制定开发区经济和社会发展总体目标，并组织实施；负责开发区招商引资、内联、外经、外贸工作；负责开发区城乡建设、基础设施和公用设施建设、房地产业、环境保护等工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

三、补充协议二的主要内容

1、协议主体

甲方：鹰潭高新区管委会

乙方：江西弘信

2、主要内容

(1) 乙方承诺：

1) 在 2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日期间，乙方累计新增设备投入不低于 2.2 亿元，包括公司（含子公司）搬迁至乙方厂区的设备不低于 9000 万元，乙方累计新购置的全新生产型机器设备不低于 1.3 亿元。

2) 在 2024 年 1 月 1 日-2028 年 12 月 31 日五个年度期间，乙方累计营业收入不低于 18 亿元，在 2024 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日三个年度期间，乙方累计营业收入不低于 8 亿元。

3) 在 2024 年 1 月 1 日-2028 年 12 月 31 日五个年度期间，乙方累计缴纳税收不低于 7000 万元。税收以甲方税务机关核准的数据为准，包括本补充协议第一条第（二）款约定的地方财政贡献扶持。

(2) 甲方按以下标准给予乙方扶持：

1) 租金扶持

在 2025 年 1 月 1 日-2027 年 12 月 31 日三个年度期间，厂房租金采取先交后补的方式，在乙方每年缴纳年度租金后 15 个工作日内给予乙方全额扶持。

2) 地方财政贡献度扶持

在 2024 年 1 月 1 日-2028 年 12 月 31 日五年度期间，按年度核算地方财政

贡献度（鹰潭市、高新区两级增值税及企业所得税）的 80%给予扶持。

3) 设备扶持

在 2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日期间，乙方新购置的全新生产型机器设备按设备投入 10%予以扶持，最高不超过 1300 万元。

4) 设备搬迁费扶持

在 2023 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日期间，对公司（含子公司）将已有设备搬迁至乙方厂区内的搬迁费用，据实给予最高不超过 400 万元的扶持，乙方凭发票经甲方审核后据实结算。

5) 贷款贴息扶持

在 2023 年 7 月 1 日-2028 年 06 月 30 日期间，甲方按贷款 1 年期的 LPR 利率（3.45%）计算给予乙方银行或其它金融机构融资贴息，贴息的总融资额不超过 2.5 亿元，贴息总额累计不超过 2500 万元，每笔贴息时间不超过 5 年，贴息资金仅限于乙方使用。

3、合作协议效力

本补充协议自各方签字盖章之日起生效，构成原合同书组成部分，与原合同书及原补充协议具有同等的法律效力，甲、乙双方应严格执行

四、对公司的影响

全球智能手机产业经历了漫长的去库存周期调整，头部手机厂商和零部件企业库存水平已从高点逐步回落至健康水平。今年四季度以来，随着新技术的研发、创新，终端品牌新机集中发布，关键品牌客户的王者归来等因素影响，新手机的销售持续增长，消费电子行业正从底部逐步恢复上行的趋势。

公司是内资高端软板研发、生产制造的代表性企业，十分看好本次以国产中高端手机大规模回归及 AI 手机、折叠屏手机等驱动的新一轮增长周期。首先，随着 AI 人工智能的大爆发，有 AI 端侧的大模型将逐步搭载于高端手机品牌，有利于手机品牌商创造更加丰富的 AI 应用生态，从而衍生出对消费者更有吸引力的应用，形成新的核心竞争力。而 AI 端侧一旦开始布署到高端手机，则意味着对手机性能的要求有了成倍的提升，具有 AI 功能的手机将会推动市场需求带来换机潮。AI 手机需要更大的电池以及更多精密器件，都需要更轻薄更精细更柔性的器件来满足手机有限的内部空间设计，对多层软板及软硬结合板等高端软板

的需求将有机会大幅提升；其次，国产中高端手机的热销、折叠机的起量，都显著带动了多层软板及软硬结合板的需求量。

由于柔性线路板具有高精度、轻薄、外形尺寸精度高、可弯折等优异特性，能很好的助力高端产品的设计及优化，类似高端马达、高端摄像头、高端医疗器械为代表的高端领域对使用高端柔性线路板方案备受欢迎，公司已有针对性的进行研发布局，并已成功导入高端马达等部分产品量产；同时，未来机器人、AR、VR 以及智能汽车等，这些高精密度的产品均需要多层软板、软硬结合板的大量配套支持，我们认为软板行业经过近几年的大幅调整出清后，真正迎来了较好的新一轮增长周期，这一轮周期将是以高技术、高品质、高性价比的高端软板为主要特征。

江西弘信是公司多层软板、软硬结合板的核心生产基地，承载着公司为国内高端客户及高端产品的配套需求。随着本轮以高端需求回归为特征的趋势，公司快速调整产品结构 with 业务定位，聚焦高端多层软板及软硬板等高端需求，对加强公司竞争力，提升公司盈利能力，特别是高端产品竞争力有着十分重要的战略意义。

本次投资将不会对公司业务独立性产生影响，不会导致公司主要业务因履行合同而对合同当事人产生依赖。

五、合同的审议程序

本事项已于 2023 年 12 月 1 日经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公

司

董事会

2023 年 12 月 1 日